

Hybrid Memory Cube Consortium Anticipa la prestazione e l'adozione nel settore di Hybrid Memory Cube Con L'Emissione di Nuove Specifiche

SAN JOSE, California e Boise, Idaho, 19 novembre 2014 (GLOBE NEWSWIRE) - L'Hybrid Memory Cube Consortium (HMCC), dedicato allo sviluppo e alla creazione di una specifica di interfaccia standard del settore per la tecnologia Hybrid Memory Cube (HMC), ha annunciato oggi il completamento e la disponibilità al pubblico della sua specifica HMCC 2.0 (HMCC 2.0).

La nuova specifica 2.0 HMCC avanza la velocità di trasmissione dati da 15 GB/s fino a 30 GB/s, che stabilisce una nuova soglia per prestazioni di memoria. HMCC 2.0, inoltre, migra il modello di canale associato da breve portata (SR) a brevissima portata (VSR) per allinearsi con la nomenclatura industriale esistente.

"Con 150 membri, l'Hybrid Memory Cube Consortium ha maturato un notevole momentum sin dal suo inizio e, di conseguenza, ha una maggior quantità e migliori input su come l'interfaccia possa meglio adattarsi alle applicazioni di domani", afferma Jim Handy, direttore, Objective Analysis. "L'emissione della specifica HMCC 2.0 mostra l'impegno a far evolvere una famiglia di specifiche rivolte a tutte le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni".

HMCC è stato fondato nell'ottobre 2011 da co-sviluppatori Altera, Micron, Open-Silicon, Samsung Electronics e Xilinx. HMCC ha completato e pubblicato la sua prima specifica nel maggio 2013, ottenendo consenso tra i principali sviluppatori di semiconduttori per promuovere l'adozione di HMC nei sistemi di nuova generazione. Dalla sua istituzione HMCC è cresciuto fino a comprendere più di 150 OEM, attivatori e integratori che partecipano regolarmente allo sviluppo e alla discussione di standard HMC. Il perfezionamento della seconda generazione di specifiche HMCC è una pietra miliare nello sviluppo di questa tecnologia di memoria innovativa e indica la sua adozione continua.

"HMCC 2.0 offre ai designer una soluzione matura per eliminare i colli di bottiglia della memoria e distribuire una nuova generazione di sistemi con prestazioni della memoria senza precedenti", ha dichiarato Hans Boumeester, vice presidente di Open-Silicon per operazioni di IP e di ingegneria. "La ratifica del nuovo standard indica che questi designer avranno accesso a IP conformi agli standard per l'immediata integrazione in chip e sistemi in grado di soddisfare le crescenti esigenze di larghezza di banda dei data center di nuova generazione e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni".

Informazioni su HMC

HMC, che è stato riconosciuto da aziende leader del settore e da fattori influenzanti come la risposta tanto attesa per affrontare i limiti imposti dalla convenzionale tecnologia di memoria, offre prestazioni ultra-elevate con sistema di potenza significativamente

inferiore in termini di bit. L'attuale generazione della tecnologia HMC offre fino a 15 volte la larghezza di banda di un modulo DDR3 e utilizza il 70 per cento in meno di energia e il 90 per cento in meno di spazio rispetto a tali tecnologie. La memoria astratta di HMC consente ai designer di dedicare più tempo all'utilizzo delle caratteristiche e prestazioni rivoluzionarie di HMC e minor tempo alla navigazione nella moltitudine di parametri di memoria necessari per implementare le funzioni di base. Gestisce anche la correzione degli errori, la resilienza, l'aggiornamento e altri parametri esacerbati da variazioni di processo di memoria.

Informazioni su HMCC

Fondato dai principali membri della comunità di semiconduttori al mondo, Hybrid Memory Cube Consortium è dedicato allo sviluppo e alla creazione di una specifica di interfaccia standard di settore per la tecnologia Hybrid Memory Cube. I membri del consorzio sono Altera Corporation, ARM, IBM, Micron Technology, Inc., Open-Silicon, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., SK Hynix Inc., e Xilinx, Inc. Per saperne di più su HMCC, visitare www.hybridmemorycube.org.

CONTACT: Karl Stetson
Zeno Group for Micron
Karl.stetson@zenogroup.com
206-297-5943